

Title (en)

Method and apparatus for levelling a metal band.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Richten eines metallischen Bandes.

Title (fr)

Procédé et installation de planage d'une bande métallique.

Publication

EP 0298852 A2 19890111 (FR)

Application

EP 88401722 A 19880701

Priority

FR 8709715 A 19870708

Abstract (en)

The subject of the invention is an apparatus for levelling a metal band (3) by passing the band along an undulated path in a levelling stand (10) associated with means for tensioning the band (3) and comprising a plurality of rollers (2, 15, 16, 18) having bevelled ends axially displaceable in opposing directions. <??>According to the invention, the bevelled parts (25) are provided respectively at opposing ends of two active levelling rollers (23) (24) and the levelling system (4) (5) formed by each active roller and the back-up rollers associated are respectively mounted on two horizontal beams which can slide vertically and are each associated with means (39) (64) for adjusting the height position and the axial position of each levelling system (4) (5). <IMAGE>

Abstract (fr)

L'invention a pour objet une installation de planage d'une bande métallique (3) par défilement de la bande suivant un trajet ondulé, dans une cage de planage (10) associée à des moyens de mise en tension de la bande (3) et comprenant, une pluralité de cylindres (2, 15, 16, 18) à extrémités amincies déplaçables axialement dans des directions opposées. Selon l'invention les parties amincies (25) sont ménagées respectivement à des extrémités opposées de deux cylindres actifs de planage (23) (24) et les équipages de planage (4) (5) formés par chaque cylindre actif et les rouleaux d'appui associés sont montés respectivement, sur deux poutres horizontales coulissant verticalement et associées chacune, à des moyens (39) (64) de réglage de la position en hauteur et de la position axiale de chaque équipement de planage (4) (5).

IPC 1-7

B21D 1/05

IPC 8 full level

B21D 1/05 (2006.01)

CPC (source: EP US)

B21D 1/05 (2013.01 - EP US)

Cited by

DE102009041852A1; EP1918036A1; DE102010024714A1; DE102010024714C5; WO2011032890A1; WO2011161134A1; CN109465311A; EP0470512A3; US5161400A; DE102010024714B4; FR2908060A1; EP0446130A1; FR2659254A1; US5127249A; CN109317975A

Designated contracting state (EPC)

BE DE FR IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0298852 A2 19890111; EP 0298852 A3 19900912; EP 0298852 B1 19931020; CS 274742 B2 19911015; CS 488788 A2 19901213; DE 3885019 D1 19931125; DE 3885019 T2 19940511; FR 2617744 A1 19890113; FR 2617744 B1 19940520; JP 2650141 B2 19970903; JP S6427718 A 19890130; US 4898013 A 19900206

DOCDB simple family (application)

EP 88401722 A 19880701; CS 488788 A 19880705; DE 3885019 T 19880701; FR 8709715 A 19870708; JP 17073988 A 19880708; US 21597388 A 19880707